

NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
Tel:044-435-5111 (大代表)
<http://www.necel.co.jp/>

株主メモ

- **事業年度** 毎年4月1日から翌年3月31日まで
- **定時株主総会** 事業年度の末日の翌日から起算して3ヵ月以内
- **基準日** 定時株主総会 毎年3月31日
 期末配当金 毎年3月31日
 中間配当金 毎年9月30日
- **単元株式数** 100株
- **株主名簿管理人** 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社
 同事務取扱場所 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部
 【郵便物送付先】 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部
 【電話照会先】 ☎ 0120-176-417
 【インターネットホームページURL】 <http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html>
 同取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店
- **公告方法** 電子公告(当社ホームページに掲載しております)
 公告用ホームページアドレス
<http://www.necel.com/ir/ja/>
- **上場証券取引所** 東京証券取引所



株主の皆様へ

NECエレクトロニクス通信

2010年3月期 上期報告書 2009年4月1日～2009年9月30日

INDEX	株主の皆様へ…………… 1	会社の概況…………… 8
	連結業績の概況…………… 3	トピックス……………10
	連結財務諸表…………… 5	



この上期報告書は、FSC認証紙を使用し、「大豆油インキ」を使い、「水なし印刷」で印刷しています。

株主の皆様へ

本年6月に代表取締役社長に就任いたしました山口純史（やまぐちじゅんし）でございます。

株主の皆様には、ご清祥のこととお慶び申し上げます。

当上期（2009年4月1日から2009年9月30日まで）の事業概況等につきましてご報告申し上げます。

当上期の世界経済を概観しますと、昨年の秋以降続いていた景気の落ち込みがようやく下げ止まり、在庫調整の進展や各国の景気刺激策による消費の押し上げなどにより、景気の回復感が強まってきました。また、半導体市場におきましても、顧客における増産や在庫積み増しに伴う部品発注の増加をうけ、期を通じて回復基調が継続いたしました。しかしながら、世界的にみても景気の先行きが依然として不透明であることや、景気刺激策が需要を先食いしていることによる反動を懸念する向きもあり、依然として予断を許さない状況であります。



このような事業環境の中、当社の当上期の連結売上高は、2,205億円と前年同期と比べ1,131億円（33.9%）の減少となりました。製品分野別では、すべての分野において売上高が減少いたしました。特に、コンピュータおよび周辺機器分野や多目的・多用途IC分野においては、大幅な売上減となりました。

連結営業損益は364億円の損失となりました。研究開発費や人件費等の削減により、前年同期と比べ大幅に固定費を削減したものの、連結売上高が前年同期と比べ大幅に減少したことなどにより、前年同期と比べ376億円の悪化となりました。連結税引前損益は375億円の損失で、前年同期と比べ375億円の悪化、連結当期純損益は381億円の損失で、前年同期と比べ362億円と悪化となりました。

中間配当の実施につきましては、誠に遺憾ではございますが、連結当期純損益が依然として損失を計上する状況であることから、見送らせていただくことといたしました。株主の皆様のご期待に添えず、深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、本年度は連結営業損益の黒字化を目標に事業を運営してまいりましたが、最先端の製造ラインの稼働悪化などにより、その達成が困難な状況となりました。一方、当社の業績は、前年度下期の大幅な赤字から、確実に改善に向かっております。引き続き固定費削減施策を着実に遂行するとともに、来年度以降の業績改善に向けて、積極的な受注活動を展開してまいります。

また、当社グループは、2009年9月16日に、株式会社ルネサス テクノロジーとの間で、当社と同社の事業統合に関する統合基本契約を締結いたしました。統合時期は2010年4月1日を予定しており、統合後の新会社は世界第3位の半導体企業となります。来年4月に向け、関係当事者間で協議を進めてまいります。

株主の皆様からの信頼回復に向け、全社一丸となり邁進する所存でございますので、何卒ご理解を賜り、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 

株主の皆様へ

NECエレクトロニクス株式会社と株式会社ルネサス テクノロジーの統合基本契約締結について

当社および株式会社ルネサス テクノロジー（以下、ルネサス）は、設立以来、半導体専門企業としてマイコンを中心に各々が事業を展開してまいりました。しかしながら、半導体市場において世界的な競争が激化するとともに、新興国市場の台頭といった構造変化が見込まれる中、より一層の経営基盤と技術力の向上を図り、顧客満足の高まる向上を通じた企業価値の増大を目指し、本年9月16日付にて、当社とルネサスの事業統合に関する統合基本契約を締結いたしました。

事業統合後の新会社は、マイコン、システムLSI、個別半導体という3つの製品群を持ち、半導体全体では世界第3位の会社となります。3つの製品群それぞれの分野で、これまで両社が培ってきた強みを一層強化するような開発リソースの選択と集中を進め、グローバルに高い競争力を持つ強い製品群の育成に力を注いでまいります。さらに、個々の製品の競争力強化だけでなく、応用製品毎にマイコンやシステムLSI、個別半導体をまとめて提供するソリューション提案によるビジネスの拡大に力を注いでまいります。

定許の競争環境を踏まえ、両社はそれぞれ独自に決定済みの構造改革を着実に進めるとともに、両社を統合することによって、統合による相乗効果を引き出し、収益力を高めて半導体市場の変動に耐えうる「強い半導体専門企業」を目指してまいります。

また、事業統合においては、当社を存続会社としてルネサスを合併する方式を採用しており、事業統合後の新会社は、株式市場への上場維持を目指しております。

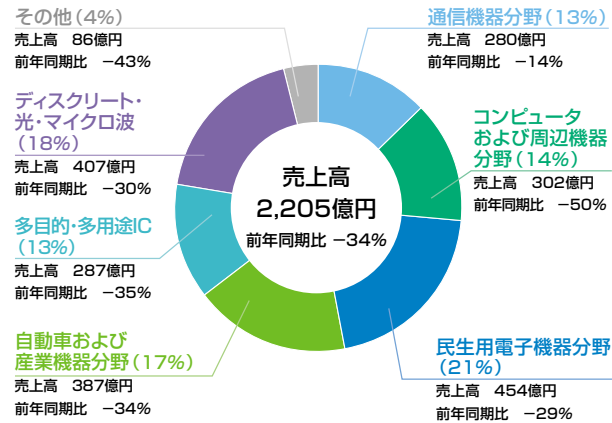
なお、当社とルネサスとの事業統合については、両社の株主総会の承認と関係当局の認可を条件としております。

●本事業統合後の新会社の主な概要

商号	ルネサス エレクトロニクス株式会社（仮称） （英文：Renesas Electronics Corporation）
本店所在地	神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
代表者	会長 山口 純史 （現NECエレクトロニクス 代表取締役社長） 社長 赤尾 泰 （現ルネサス テクノロジー 代表取締役 取締役社長）
統合予定日	2010年4月1日

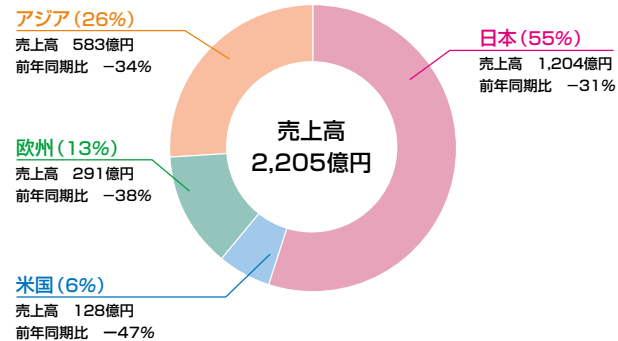
連結業績の概況

●製品分野別売上高



売上高は回復傾向にあるものの、前年同期比では全般的に売上が減少

●所在地別売上高

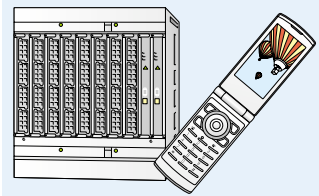


地域を問わず全般的に売上が減少

(注) 本上期報告書に記載されているすべての連結財務情報は、米国会計基準に準拠しています。

●製品分野別の概況

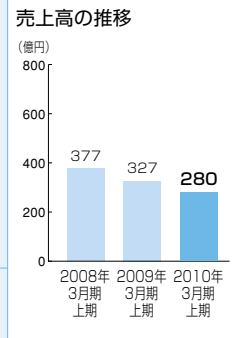
通信機器分野



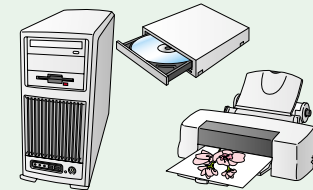
ルータや携帯電話基地局などのブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体、携帯電話端末向け半導体

ブロードバンド・ネットワーク機器および携帯電話端末向け半導体の売上が減少

当上期は、主にブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や、携帯電話端末向けカメラLSIやLCD(液晶ディスプレイ)ドライバICの売上が前年同期と比べ減少いたしました。



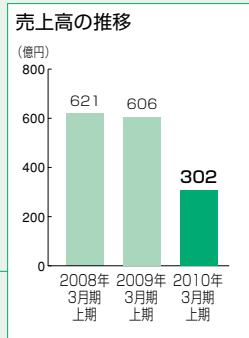
コンピュータおよび周辺機器分野



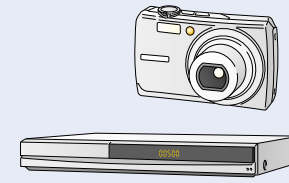
サーバおよびワークステーション向け半導体、パソコン周辺機器向け半導体

パソコン周辺機器向け半導体の売上が減少

当上期は、主に液晶テレビやパソコン用モニタ向けLCDドライバICやDVDドライブ向けLSIの売上が前年同期と比べ減少いたしました。



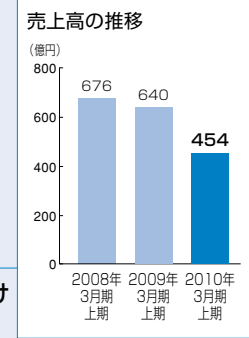
民生用電子機器分野



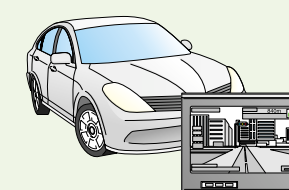
家電製品向け半導体、ゲーム機向け半導体

ゲーム機および白物家電向け半導体の売上が減少

当上期は、ブルーレイ・ディスク機器向け画像処理LSI「EMMA(エマ)」の売上が前年同期と比べ増加したものの、ゲーム機向け半導体や白物家電向け半導体などの売上が前年同期と比べ減少いたしました。



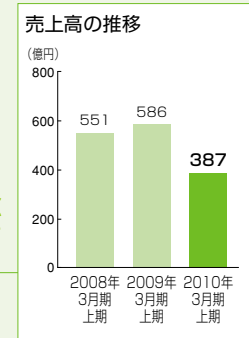
自動車および産業機器分野



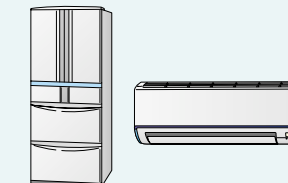
自動車向け半導体、FA(ファクトリー・オートメーション)機器などの産業機器向け半導体

自動車向け半導体の売上が減少

当上期は、主に自動車向けマイクロコントローラの売上が前年同期と比べ減少いたしました。



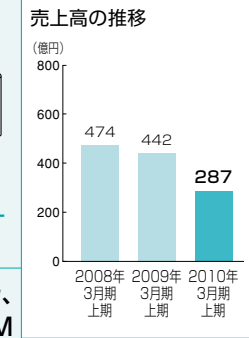
多目的・多用途IC



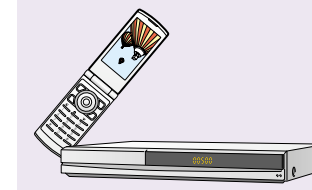
汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途SRAMなど

汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途SRAMの売上が総じて減少

当上期は、市場環境悪化による需要減などにより、汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途SRAMの売上が、総じて前年同期と比べ減少いたしました。



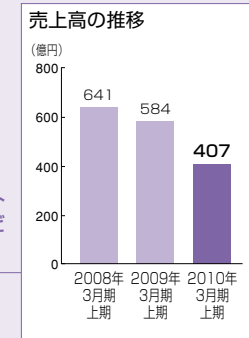
ディスクリート・光・マイクロ波



トランジスタなどのディスクリート半導体、光通信や携帯電話端末などに使われる光・マイクロ波半導体

ディスクリート半導体、化合物半導体の売上が減少

当上期は、ディスクリート半導体や、光半導体・マイクロ波半導体など化合物半導体の売上が、市場環境悪化による需要減などにより前年同期と比べ減少いたしました。



連結財務諸表

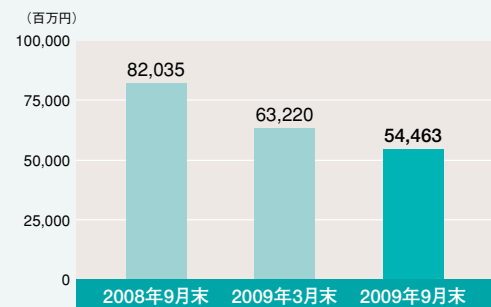
●連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	前期末 2009年3月31日現在	当期末 2009年9月30日現在
資産の部		
流動資産	222,177	218,089
現金および現金同等物	101,279	89,470
受取手形および売掛金	52,488	67,057
たな卸資産	63,220	54,463
その他の流動資産	5,190	7,099
固定資産	260,368	247,366
投資等	3,474	3,908
有形固定資産	242,079	230,393
その他の資産	14,815	13,065
資産合計	482,545	465,455

たな卸資産

前期末比 **88 億円減**
 キャッシュ・フローの改善をはかるため、たな卸資産の適正化に努めたことなどにより、前期末と比べて88億円の減少となりました。

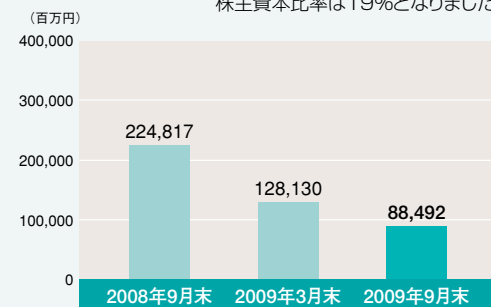


(単位：百万円)

科目	前期末 2009年3月31日現在	当期末 2009年9月30日現在
負債・純資産の部		
流動負債	141,907	145,326
短期借入金	1,905	7,937
支払手形および買掛金	78,763	78,605
その他の流動負債	61,239	58,784
固定負債	208,387	227,838
社債および長期借入金	114,966	135,767
未払退職および年金費用	81,167	80,761
その他の固定負債	12,254	11,310
株主資本	128,130	88,492
資本金	85,955	85,955
資本剰余金	281,081	281,081
利益剰余金	△197,521	△235,611
その他の包括損益累計額	△41,374	△42,922
自己株式	△11	△11
非支配持分	4,121	3,799
負債および純資産合計	482,545	465,455

株主資本

前期末比 **396 億円減**
 四半期純損失を381億円計上し、利益剰余金が減少したことなどにより、前期末と比べて396億円の減少となりました。その結果、株主資本比率は19%となりました。



●連結損益計算書

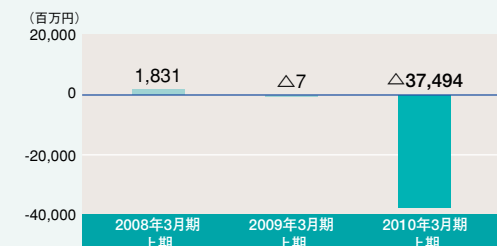
(単位：百万円)

科目	前上期 2008年4月1日～ 2008年9月30日	当上期 2009年4月1日～ 2009年9月30日
売上高	333,588	220,467
売上原価	233,979	174,913
研究開発費	56,720	48,389
販売費および一般管理費	41,683	33,557
営業損益	1,206	△36,392
営業外収益	2,126	1,923
受取利息および配当金	1,023	151
雑収益	1,103	1,772
営業外費用	3,339	3,025
支払利息	228	253
雑損失	3,111	2,772
税引前損益	△7	△37,494
法人税等	1,920	1,292
持分法による投資損益	145	107
非支配持分属損益控除前四半期純損益	△1,782	△38,679
非支配持分属損益(控除)	125	△589
四半期純損益(当社株主に帰属)	△1,907	△38,090

(注) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

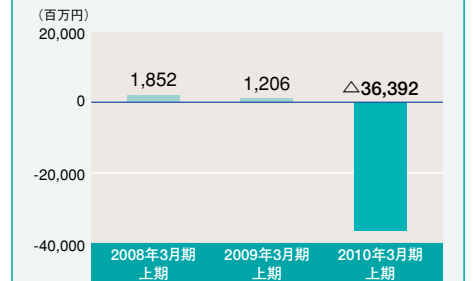
税引前損益の推移

前年同期比 **375 億円悪化**
 営業損益が大幅に悪化したことにより、前年同期と比べて375億円悪化し、税引前損益は375億円の損失となりました。



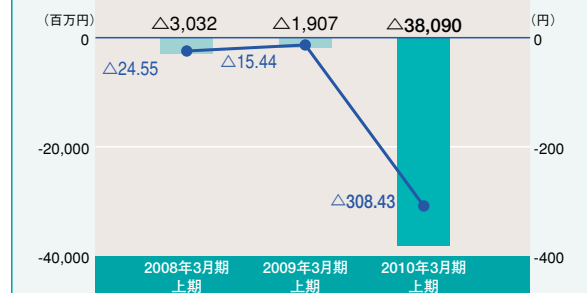
営業損益の推移

前年同期比 **376 億円悪化**
 研究開発費や人件費の削減等により、前年同期と比べ大幅に固定費を削減したものの、売上高が前年同期と比べ大幅に減少したことなどにより、前年同期と比べ376億円の悪化となりました。



当期純損益・1株当たり当期純損益の推移

前年同期比 **362 億円悪化**
 当期純損益は38,090万円、1株当たり当期純損益は308.43円となりました。



連結財務諸表

●連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項目	前上期 2008年4月1日～ 2008年9月30日	当上期 2009年4月1日～ 2009年9月30日
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー		
非支配持分帰属損益控除前四半期純損益	△ 1,782	△ 38,679
営業活動により増加したキャッシュ(純額)への調整		
減価償却費等	32,993	28,197
受取手形および売掛金の(増加)減少額	866	△ 16,930
たな卸資産の(増加)減少額	△ 6,392	7,886
支払手形および買掛金の増加(減少)額	△ 1,448	9,061
その他	△ 5,403	△ 3,510
計	18,834	△ 13,975
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産売却額	395	2,605
有形固定資産購入額	△ 22,167	△ 26,011
その他	△ 1,596	△ 828
計	△ 23,368	△ 24,234
フリー・キャッシュ・フロー (I + II)	△ 4,534	△ 38,209
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債および借入金の増加(減少)額	△ 1,116	12,147
セールス・アンド・リースバック取引による入金額	-	15,992
その他	△ 1,211	△ 1,498
計	△ 2,327	26,641
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	△ 582	△ 241
現金および現金同等物純増加(減少)額	△ 7,443	△ 11,809
現金および現金同等物期首残高	165,472	101,279
現金および現金同等物期末残高	158,029	89,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

140 億円の支出

四半期純損益の損失計上や、受取手形および売掛金の増加などにより、140億円の支出となりました。但し、第2四半期においては、黒字転換を果たしております。

投資活動によるキャッシュ・フロー

242 億円の支出

有形固定資産の購入による支払が260億円あったことなどにより、242億円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

266 億円の収入

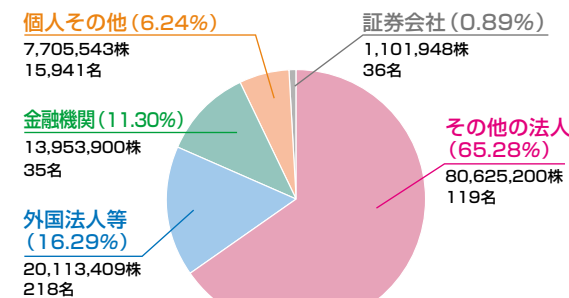
有形固定資産のセール・アンド・リースバック取引による入金や、借入を実行したことなどにより、266億円の収入となりました。

会社の概況

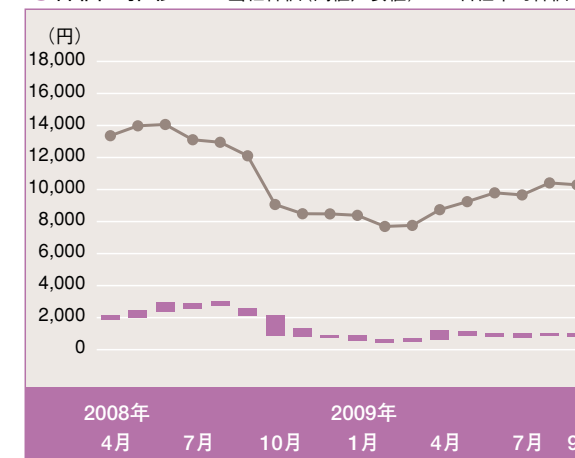
株式の状況 (2009年9月30日現在)

- 会社が発行する株式の総数 400,000,000株
- 発行済株式の総数 123,500,000株
- 株主数 16,349名

●所有者別状況



●株価の推移



(注) 日経平均株価は終値の月次平均を表示しております。

●大株主 (上位10名)

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本電気株式会社	80,300	65.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口)	6,200	5.02
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST, LONDON-CLIENT ACCOUNT	2,797	2.27
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OMO2	2,201	1.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2,167	1.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1,573	1.27
MELLON BANK, N.A. TREATY CLIENT OMNIBUS	1,074	0.87
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	1,041	0.84
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT	889	0.72
DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-TREATY CLIENTS 613	734	0.60

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口) の持株数6,200千株 (持株比率5.02%) は、日本電気株式会社が保有する当社株式の一部を退職給付信託に拠出したものであり、その議決権行使の指図権は日本電気株式会社が留保しております。

●お問い合わせ先

NECエレクトロニクス株式会社
コーポレートコミュニケーション部 IR担当
Tel: 044-435-1664 e-mail: ir@necel.com

会社の概況

会社の概要 (2009年9月30日現在)

- 商号 NECエレクトロニクス株式会社
- 創立 2002年11月1日
- 資本金 860億円
- 事業内容 システムLSIを中心とした各種半導体に関する研究、開発、製造、販売およびサービス
- 従業員数(連結) 22,207名
- 本社 〒211-8668
神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
Tel: 044-435-5111 (大代表)
- 主な関係会社
 - 国内生産会社 NECセミコンダクターズ山形
NECセミコンダクターズ関西
NECセミコンダクターズ九州・山口
 - 国内販売・設計会社 NECマイクロシステム
 - 海外生産会社 NECエレクトロニクス・アメリカ*1
NECセミコンダクターズ・シンガポール
NECセミコンダクターズ・マレーシア
首鋼NECエレクトロニクス
 - 海外販売・設計会社 NECエレクトロニクス・ヨーロッパ
NECエレクトロニクス台湾
NECエレクトロニクス・シンガポール
NECエレクトロニクス中国
NECエレクトロニクス香港
NECエレクトロニクス上海
NECエレクトロニクス韓国

- 取締役、監査役および執行役員
 - 代表取締役社長 山口 純史
 - 取締役執行役員常務 矢野 陽一
 - 取締役執行役員常務 加藤 正記
 - 取締役 松倉 肇
 - 監査役 鈴木 啓士 (常勤)
 - 川村 廣樹 (常勤)
 - 柴田 保幸
 - 池永 薫
 - 執行役員 佐藤 博
 - 福間 雅夫
 - 吉野 達雄
 - 三浦 芳彦
 - 宮路 吉朗
 - 山田 和美
 - 岩元 伸一

お知らせ

IRホームページを是非ご覧下さい!

当社のIRホームページには、決算関連の資料はもちろん、当社の事業である半導体の開発、生産などについてアニメーションや動画を交えて、わかりやすくご紹介するコンテンツも用意しております。是非一度ご覧下さい。


<http://www.necel.com/ir/ja/>

*1: NECエレクトロニクス・アメリカは生産および販売を担当しています。

トピックス

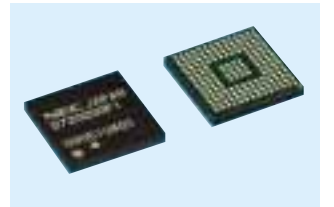
新製品

USB (Universal Serial Bus) の次世代規格、USB3.0に準拠したLSIを世界で初めて製品化

当社はこのたび、パソコン、デジタル家電、キーボード、マウスなどの電気・電子機器に幅広く用いられているインタフェース規格であるUSB(Universal Serial Bus)の次世代規格、USB3.0に準拠したLSIを世界で初めて製品化したしました。

USBは、様々な機器を同一のケーブルで接続できること、現世代のUSB2.0においては、480Mbpsという高速なデータ転送規格が追加されたことから現在、世界中に幅広く普及しています。当初はキーボードやマウスといった周辺機器の接続が主な用途でしたが、現在では、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真・映像などの大容量データの転送にも用いられるようになってきており、データ転送速度の高速化へのニーズが高まってきております。しかしながら、パソコンを中心とするデータ転送においてUSB2.0の速度の遅さが課題となっております。本製品は、データ転送速度を飛躍的に向上させるために開発されたLSIであり、ストレスのない大容量データ転送が実現できるようになります。

当社は、USB3.0対応機器の普及が2010年より本格的に始まると見込んでおり、本製品の積極的な拡販活動を展開してまいります。



製品

デジタルAV機器向けシステムLSI「EMMA(エマ)」シリーズが累計1億個の出荷を達成

当社は、1999年3月に世界で初めてデジタル放送受信用のセット・トップ・ボックス(STB)向けシステムLSI「EMMA」の市場投入開始以来、DVDレコーダーの主要な機能を1チップ化した「EMMA2R」(2002年)、ブルーレイ・プレーヤーに必要な機能を1チップで実現する「EMMA3PF」(2008年)をそれぞれ世界で初めて市場投入し、製品ラインアップの拡充を図ってまいりました。

「EMMA」シリーズは、STB、デジタルテレビ、DVD・ブルーレイレコーダー/プレーヤーを同一のアーキテクチャで対応できる唯一のシステムLSIであり、アプリケーションソフトの継承性を重視しているほか、ユーザーの設計・開発期間短縮を目的として、開発ツールや様々なミドルウェアの整備を行ってきました。こうした取り組みの結果、現在では、総製品数40種類の「EMMA」シリーズ製品が、世界15カ国・80社に出荷されております。

当社は今後、システム開発のコスト低減に貢献する製品の開発や開発期間を短縮する開発ツールの整備を図るだけでなく、さらなる高画質化を実現する当社独自の超解像技術を生かしたり、モバイル機器向けシステムLSIなどの開発で培ってきた様々な低消費電力技術を活用することで、より一層、市場ニーズを反映させた「EMMA」シリーズの開発を進めてまいります。

